

M-VIA Flex® FR4-Flex基板

Semiflex PWB

特長 Features

- FR-4.0, 4.1のプリント配線板材料で屈曲できる基板
Bendable PWB with FR-4.0, 4.1 Material

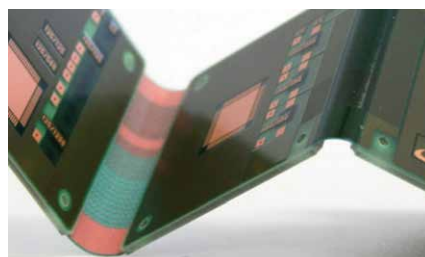
コンセプト Concept

フレックスリジッド基板より簡素プロセス
Simpler Process than Flex-Rigid

同一接続 (コネクタレス)
Single Board Connection (Connector Less)

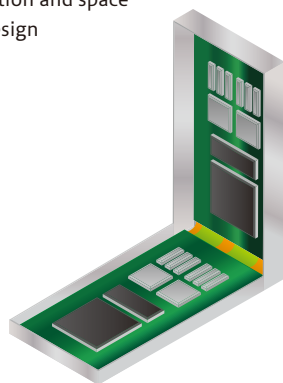
ポリイミド材レス通常PWB材料 (PI less)
Ordinary PWB Material (PI less)

基板屈曲例 Examples of Bendable PWB

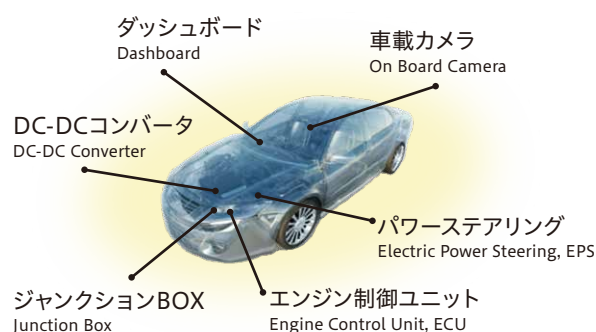


メリット Merit

- 工程簡素化による低コスト化のみでなく、コネクタレスによる小型化・省スペース化への貢献
Contribution to cost reduction through process simplification and to miniaturization and space saving through connector-less design



用途 Applications

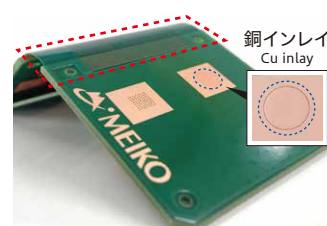
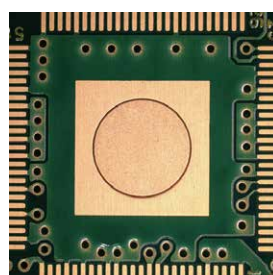
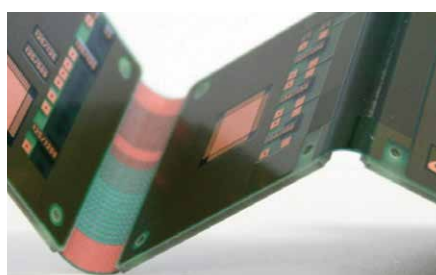


- 車載向け：EPS、ECU、カーナビ
- 民生向け：SSD、照明器具、医療機器 等

更なるソリューション Further Solutions

R&D

- M-VIA Flex® FR4-Flex+銅インレイにより小型化・3D実装に放熱機能を追加
M-VIA Flex® FR4-Flex + Cu inlay adds heat dissipation to miniaturization and 3D mounting



銅インレイ基板と組合せ構造
Structure for Cu inlay and FR4-Flex